

**OMNIMATE Housing - série CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Contact FE
Fiabilité de fonctionnement - que ce soit complètement intégré ou simplement monté

Le raccordement optionnel "CH20M FE" protège de manière optimale votre système, avec un contact du rail profilé pour la mise à la terre.

- Le contact de mise à la terre préconfectionné dans le boîtier de 6 mm permet un raccordement sûr et permanent du blindage électronique du circuit électronique sur le rail profilé (ex. "CH20M6 BP 4P-4P FE BK", 1164650000)
- Un contact de mise à la terre, qui peut être traité de manière totalement automatique par refusion avec les connecteurs mâles et un contact bus optionnel, est disponible pour les boîtiers de 12,5 à 67,5 mm. La position du PCB dans le boîtier définit la longueur du picot de 1,5 mm / 3,2 mm

Informations générales de commande

Type	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Référence	1189370000
Version	Boîtiers vides pour l'électronique, Accessoires, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 1, Longueur du picot à souder (!): 1.5 mm, étamé, Tape
GTIN (EAN)	4032248972715
Cdt.	750 pièce(s)
Indices de produit	UL:
Emballage	Tape

Fiche de données

OMNIMATE Housing - série CH20M CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,482 g

Données des matériaux

Surface du contact étamé

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984

Classifications

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-18-92-90
eClass 7.1	27-18-92-90	eClass 8.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

Remarques

Remarque

Conformité IPC Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Données techniques	STEP

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.